

Press Information

1GHz、高速 1:5 LVPECL/LVDS から LVDS へのリピータ

MAX9310/MAX9310A 及び MAX9317/MAX9317A/MAX9317B/MAX9317C が、LVPECL-LVDS クロックドライバファミリに追加されました。MAX9310/MAX9310A はシングル 1:5 LVPECL から LVDS へのクロックドライバで、MAX9317 ~ MAX9317C はデュアル 1:5 LVPECL/LVDS から LVDS へのクロックドライバです。これらのクロックドライバは、2 つの LVPECL/HSTL/LVDS 差動又は、シングルエンド信号源を入力マルチプレクサへ受け入れ、LVDS へ変換します。差動出力レベルは、ANSI TIA/EIA-644 LVDS 規格に準拠しています。固有の低ジッタ性能(0.8ps(RMS))と低出力間スキュー(10ps typ)は、信号とクロックの完全性が重要となる DSLAM、基地局、電話局交換機、ネットワークスイッチやルータ、SONET/SDH 通信アプリケーションのクロック及びデータの分配に最適です。

MAX9310/ MAX9317/MAX9317A は、2.5V システムでの使用には、2.375V ~ 2.625V の電源で低電圧動作するように設計されており、MAX9317A/MAX9317B/MAX9317C は、公称 3.3V 電源のシステムにおいて 3V ~ 3.6V で動作するように設計されています。MAX9317B/MAX9317C には、外付け部品点数を削減するために 50 の終端抵抗が内蔵されています。差動出力電圧(V_{OD})は、1GHz で 250mV 以上です。これらのデバイスは、工業用拡張温度範囲(-40 ~ 85)での動作が保証されています。

シングル 1:5 MAX9310/MAX9310A クロックドライバは、20 ピン TSSOP パッケージで提供されます。デュアル MAX9317 ~ MAX9317C クロックドライバは、32 ピン TQFP 及び QFN パッケージで提供されます。32 ピン QFN パッケージは、TQFP パッケージに比べ熱特性に優れ、基板面積は 70% 削減されます。MAX9317B は、MC100EP210S とピンコンパチブルです。パッケージ情報については、MAX9310/MAX9310A 及び MAX9317 ~ MAX9317C のデータシートを参照してください。

